

## 公司概況資料表

以下資料由鴻勁精密股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

### 認購相關資訊

#### 公司簡介

#### 主要業務項目

#### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

#### 最近五年度簡明資產負債表

#### 最近三年度財務比率

公司名稱：**鴻勁精密股份有限公司** (股票代號：7769)

董事長	謝啟達
總經理	張簡榮力
資本額	新台幣1,616,000,000元
輔導推薦證券商	元大證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	元大證券股份有限公司 鄭小姐 (02) 2718-1234分機6784
註冊地國	非外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	非外國發行人，故不適用

### 輔導推薦證券商認購鴻勁公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	元大證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
認購日期	113年9月19日	113年9月18日
認購股數(股)	1,350,000	150,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	0.84%	0.09%
認購價格	每股新台幣 559元	
認購價格之訂定依據及方式	<p>本推薦證券商參酌一般市場認購價格訂定方式，評估市價法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購鴻勁精密股份有限公司(以下簡稱鴻勁或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>基於目前股票價值的評估方法諸多種類，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法主要包括：</p>	

- 1.市場基礎法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，係透過已公開的資訊與整個市場、產業性質相近的同業與被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整。
- 2.成本法：係以帳面之歷史成本資料作為公司價值評定基礎的淨值法。
- 3.現金流量折現法：為採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。

以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本推薦證券商主要採用市場法-本益比法作為評估基準。

鴻勁公司為半導體IC測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，提供IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案，並擁有高精度之溫控技術，聚焦高階半導體測試領域之應用，客戶涵括全球各大IC設計公司、封裝/測試廠及IDM半導體製造廠商。

綜觀目前國內上市櫃公司尚無業務內容與該公司完全相同者，考量營運規模、所屬產業上下游關聯性及產品應用領域後，選擇上市公司致茂電子股份有限公司(以下簡稱致茂，股票代碼：2360)，主要從事精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與全方位Turnkey測試及自動化解決方案等業務；上市公司穎崴科技股份有限公司(以下簡稱穎崴，股票代碼：6515)，主要從事半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組等開發製造業務；上市公司辛耘企業股份有限公司(以下簡稱辛耘，股票代碼：3583)主要提供半導體後段封裝濕製程設備研發製造及設備代理業務及上櫃公司旺矽科技股份有限公司(以下簡稱旺矽，股票代碼：6223)主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務作為採樣同業。茲將其採樣同業、上市(櫃)半導體類股最近三個月(113年7月~113年9月)之本益比列示如下：

單位：倍

公司	月份	113年7月	113年8月	113年9月	最近三個月平均
致茂(2360)		33.30	30.75	34.08	32.71
穎崴(6515)		69.10	61.72	71.82	67.55
辛耘(3583)		46.14	44.19	41.97	44.10
旺矽(6223)		37.87	39.74	44.25	40.62
上市半導體類		27.48	26.06	26.07	26.54
上櫃半導體類		27.34	29.31	27.57	28.07

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

經參考該公司採樣同業、上市半導體業類股及上櫃半導體業類股最近三個月(113年7~9月)平均本益比，剔除極端值穎崴之平均值

67.55後，計算其採樣同業平均本益比區間落在26.54倍~44.10間，另依據鴻勁公司最近四季(112年7月~113年6月)經會計師查核簽證或核閱之財務報告稅後淨利3,213,586千元，及截至目前為止之已發行股份總數161,600千股計算之每股盈餘19.89元為計算基礎，按上述本益比區間計算其參考價格約為527.88~877.15元，另參酌該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性及考量興櫃流動性風險後，本主辦輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股559元，介於上述參考價格區間，尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司介紹

鴻勁精密股份有限公司成立於民國104年，為半導體IC測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，透過ATC主動式溫控系統，搭配瞬間製冷、瞬間加熱、分區控溫及散熱均溫等技術，建置晶片所需之測試環境，並於前述測試環境下提供IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。

鴻勁公司投入IC測試分選設備領域多年，並專注自有技術開發及專利發展，擁有600項以上專利，其中發明專利約占95%以上，並聚焦高階半導體測試領域，為專注於半導體終端測試(final Testing)及系統級測試(System level Testing)之測試分選設備整合性解決方案之專業廠商，其產品具客製化特性，並與客戶培養出長期信賴關係，主要客戶涵括全球各大IC設計公司、封裝/測試廠及IDM半導體製造廠商。

### 二、歷史沿革

日期	重要記事
104 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司於台中市創立，實收資本額新台幣 1,000 仟元整。</li> <li>● 通過 ISO9001 認證。</li> <li>● 開發三溫 ATC 主動溫度控制技術。</li> </ul>
105 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 成立薩摩亞子公司 TOP Vintage International LTD.及中國孫公司鴻勁興業精密科技(蘇州)有限公司。</li> <li>● 開發三溫 MEMS/動態感測器測試解決方案、三溫 FT HT-1026 系列、16 工位邏輯分選機 HT-9064LS 系列、高速 SLT HT-3016H 系列、倉儲式 SSD HT-3342 系列。</li> <li>● 開發溫度控制技術 ATC5.1 系列。</li> </ul>
106 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發 COF 測試分選機 HT-6000 系列、DDR3 測試分選機 HT-3115 系列、32 工位邏輯分選機 HT-9132 系列。</li> <li>● 開發溫度控制技術 ATC3.1 系列。</li> </ul>
107 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購置中清路 11 號廠房。</li> <li>● COF 測試分選機完成研發生產。</li> <li>● 開發常高溫分選機 HT-7080B 系列、COF 測試分選機 HT-6000N 系列。</li> <li>● 開發溫度控制技術 ATC3.2 系列。</li> </ul>
108 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購置中清路 17 號土地。</li> <li>● 開發 5G 測試解決方案。</li> </ul>
109 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購置中清路 7 號廠房及高雄辦公室。</li> <li>● 動工興建中清路 17 號廠房。</li> </ul>

110 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 榮獲日月光集團最佳設備供應商獎。</li> <li>● 榮獲寰邦科技年度優秀供應商。</li> <li>● 成立創發部，專注創新技術開發</li> </ul>
111 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購置龍善廠廠區。</li> <li>● 成立美國子公司 HON.PRECISION, USA INC.。</li> <li>● 成立視覺部，專注視覺相關系統開發與提升。</li> </ul>
112 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 參加美國 SEMICON West 2023 展。</li> <li>● 榮獲華泰電子年度績優供應商。</li> <li>● 榮獲江蘇長電集團最佳交付供應商。</li> <li>● 中清路 17 號廠房啟用。</li> </ul>
113 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中國孫公司鴻勁興業精密科技（蘇州）有限公司購置之自有廠房啟用。</li> <li>● 公開發行申報生效。</li> <li>● 通過 ISO45001 認證。</li> </ul>

### 三、經營理念

#### (一) 客戶第一

專注於自有技術開發，與客戶攜手合作，提供客製化之完整性解決方案，以及時滿足客戶服務與需求。

#### (二) 品質至上

透過 ISO9001 品質管理制度，嚴格控制每個製程及檢測環節，確保產品品質符合標準。

### 四、未來展望

#### (一) 短期業務發展計畫

1. 發展海外子公司，提供海外客戶更即時而有效率之服務，以開發新地區業務版圖。
2. 持續人才招募與培訓，建立優秀人才庫以配合公司穩定發展。
3. 運用在半導體測試領域的獨特競爭優勢，搭配有效率之售後服務能力，深化客戶黏著度。
4. 參與國際組織並透過展覽發表研發成果，以提升知名度並拓展海外市場。

#### (二) 中、長期業務發展計畫

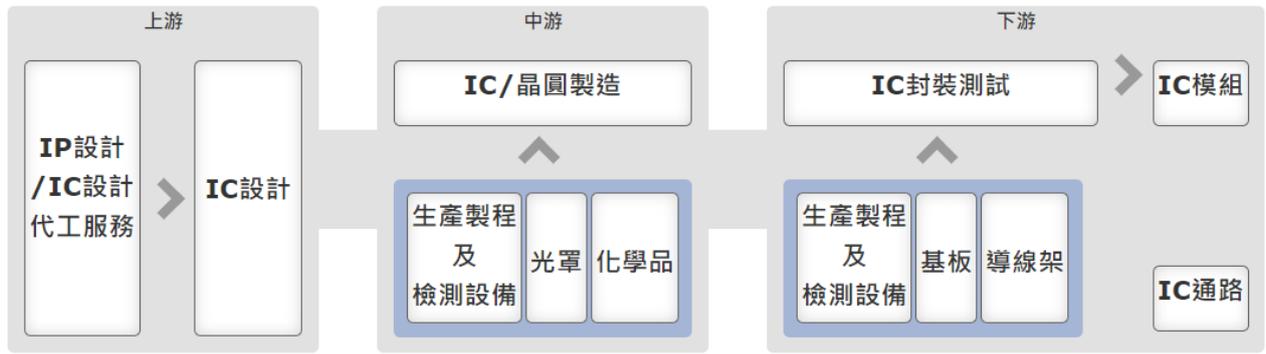
1. 專注自有技術開發及發展專利，開發領先業界之先進封裝測試解決方案。
2. 加強產品及技術垂直整合，搭配完整功耗測試方案，以與終端客戶攜手打造新產品之方式，滿足全球終端客戶之新設備導入需求。
3. 開發海外代理商，拓展新市場。

TOP ^

### 主要業務項目：

主要為半導體 IC 測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，提供 FT 測試分選機、SLT 測試分選機、Flash/Memory 測試分選機、COF 測試分選機、其他測試分選機，搭配各式 ATC 溫度控制解決方案、測試設備轉換治具及各類模組等。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額 (千元)	佔總營 收比重 (%)
半導體測試及其他設備		主要應用於 IC 設計驗證或成品測試階段，透過 ATC 主動式溫控系統建置 IC 所需之測試環境，並於前述測試環境下將半導體元件於機台內進行電性或其他性能測試，並根據檢測結果自動分選或標記。	6,762,435	71.26%
治具及各類模組	—	半導體測試設備所需之轉換治具及各類模組	2,117,873	22.32%
其他	—	零件、維修、勞務等	609,129	6.42%
合計			9,489,437	100.00%

## 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年	109年	110年	111年	112年	113年截至9月份止 (自結數) (註2)
	營業收入		6,679,017	10,854,339	12,291,915	13,469,491	9,489,437
營業毛利		2,434,443	4,432,536	5,711,898	6,233,814	4,666,566	5,018,810
毛利率(%)		36.45%	40.84%	46.47%	46.28%	49.18%	55.57%
營業損益		1,818,604	3,784,770	4,317,073	5,006,208	3,765,965	4,093,623
營業外收入及支出		(44,683)	(175,553)	(185,723)	683,706	120,680	103,774
稅前損益		1,773,921	3,609,217	4,131,350	5,689,914	3,886,645	4,197,397
稅後損益		1,411,222	2,811,509	3,198,319	4,365,452	3,067,812	3,320,437
每股盈餘(元) (註3)		8.81	17.47	19.84	27.22	19.17	20.55
發放	現金股利 (元)(註4)	10.36	14.04	8.5	40.00	30	—
	現金股利(資本公積發放現金股利)(元)	—	—	—	11.08	—	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	—	10.00	—	24.08	—	—

註1：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。該公司自109年1月1日起首次適用國際財務報導準則，108年度財務報告係依照商業會計法、企業會計準則公報及其解釋編製。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註3：每股盈餘均已追溯調整無償配股之影響。

註4：係依該年底之已發行股份總數計算之。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣千元

項目		108年	109年	110年	111年	112年
流動資產		5,407,992	8,263,768	12,103,939	14,638,325	14,743,914
不動產、廠房及設備		544,622	1,112,074	1,241,016	1,580,097	1,771,262
無形資產		3,527	3,777	2,935	10,926	10,699
其他資產		229,576	117,389	146,022	205,927	351,211
資產總額		6,185,717	9,497,008	13,493,912	16,435,275	16,877,086
流動負債	分配前	3,547,539	4,423,381	5,581,578	4,758,316	4,524,821
	分配後	3,788,806	4,751,797	5,980,685	7,156,731	9,324,821
非流動負債		209,140	211,111	188,720	22,464	36,850
負債總額	分配前	3,756,679	4,634,492	5,770,298	4,780,780	4,561,671
	分配後	3,997,946	4,962,908	6,169,405	7,179,195	9,361,671
股本	分配前	232,871	233,862	469,538	469,538	1,600,000
	分配後	232,871	467,724	469,538	1,600,000	1,600,000
資本公積	分配前	492,526	501,948	520,263	520,263	—
	分配後	492,526	501,948	520,263	—	—
保留盈餘	分配前	1,704,780	4,169,518	6,782,105	10,637,204	10,696,402
	分配後	1,463,513	3,607,240	6,382,998	7,628,590	5,896,402
其他權益		(1,139)	(76,580)	(102,382)	27,490	19,013
庫藏股票		—	—	—	—	—
非控制權益		—	33,768	54,090	—	—
股東權益總額	分配前	2,429,038	4,862,516	7,723,614	11,654,495	12,315,415
	分配後	2,187,770	4,534,100	7,324,507	9,256,080	7,515,415

註：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。該公司自109年1月1日起首次適用國際財務報導準則，108年度財務報告係依照商業會計法、企業會計準則公報及其解釋編製。

TOP ^

最近三年度財務比率

項目		110年	111年	112年
財務比率	毛利率(%)	46.47	46.28	49.18
	流動比率(%)	216.86	307.64	325.85
	應收帳款天數(天)	70.19	78.33	70.33
	存貨週轉天數(天)	191.10	240.13	350.96
	負債比率(%)	42.76	29.09	27.03

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)

修訂日期：113年10月